

信頼性試験結果

Reliability Test

XC6194 シリーズ

XC6194 Series

パッケージ

Package

USP-8B06

RoHS対応品 / RoHS Compliance

ハロゲン&アンチモンフリー / Halogen & Antimony-Free

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions		時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	125°C VIN=PG=SW=6.3V		1000	0/22
2	高温保存 High Temperature Storage	150°C		1000	0/22
3	温度サイクル Temperature Cycle	- 65°C ~ 150°C 各30分 30min each		100CYC.	0/22
4	プレッシャークーカーバイアス HAST	130°C85%RH 2×10^5 Pa VIN=PG=SW=6.3V		100	0/22
5	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020		-	0/11
6	静電耐圧 Electric Static Discharge	MM	R=0Ω C=200pF ±200V	3回 3 times	0/5
		HBM	R=1500Ω C=100pF ±1kV	3回 3 times	0/5
		CDM	±500V	3回 3 times	0/5
7	ラッチアップ Latch-Up	R=0Ω C=200pF ±100V		3回 3 times	0/5
		±50mA		3回 3 times	0/5

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	試験結果 Result r/n
1	接合強度試験 Adhesive Strength Test	PKG側面を10N 10秒間加圧する (EIAJ ED7403) apply a pressure of 10N on the side face of the PKG for 10sec.	0/5
2	基板反り試験 Bending Test	たわみ量 5mm 5±1s 1回 (EIAJ ED4702) Strain 5mm 5±1s 1time (EIAJ ED4702)	0/5
3	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒 (プロファイル昇温法) 230°C 10s (Temperature profile method)	0/11